報道関係者各位

株式会社BEAM Technologies
2026年11月6日

軌道上での半導体製造スタートアップの㈱BEAM Technologies 防衛装備庁主催「防衛産業参入促進展 DIPEX2026」に出展

宇宙で作る種結晶と地上での量産を組み合わせた、化合物半導体基板の製造技術をご紹介します

理化学研究所発の宇宙軌道上製造スタートアップである株式会社BEAM Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役：飯村 一樹、以下「BEAM」）は、2026年11月12日（木）・13日（金）にベルサール汐留で開催される防衛装備庁主催「防衛産業参入促進展 DIPEX2026」に、SEEDS企業として出展いたします。

ブースでは、宇宙の微小重力環境で作製する種結晶と、地上でのバルク結晶成長を組み合わせた化合物半導体基板の製造技術と、国内での供給体制づくりの取り組みをご紹介します。

出展の概要

- 展示会名：防衛産業参入促進展 DIPEX2026
- 会期：2026年11月12日（木）10:00～17:00／13日（金）10:00～16:00
- 会場：ベルサール汐留 B1ホール
- 主催：防衛装備庁
- 出展区分：SEEDS企業
- 来場方法：事前登録制（公式サイトの来場申込フォームからお申し込みください）
- 公式サイト：https://dipex2026.com/

DIPEX2026について

「防衛産業参入促進展 DIPEX2026」は、有望なスタートアップや中小企業と、防衛関連企業とのマッチングを目的に防衛装備庁が開催する展示会です。

防衛装備庁は、サプライチェーンの強靭化、民生先端技術の取り込み、防衛生産技術基盤の強化を目的に、優れた技術や製品を持つ企業の防衛産業への参入を進めています。本展示会はその取り組みの一環として開催され、技術を持つSEEDS企業と、課題やニーズを持つプライム企業・Tier1企業との商談の場が設けられます。

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞
株式会社BEAM Technologies　担当：田中　MAIL：info@beam-tec.co.jp

展示内容

赤外線センシングや高周波通信をはじめとする先端デバイスの性能は、その土台となる化合物半導体基板の結晶品質に大きく左右されます。地上でのバルク結晶成長では、重力に起因する熱対流や成分の偏析が結晶欠陥の要因となります。また、高品質な化合物半導体基板は海外製品への依存度が高く、装備品の安定した製造と維持整備の観点からも、国内での供給体制が求められています。

BEAMは、宇宙の微小重力環境で種結晶を作製し、その種結晶をもとに地上でインゴットを成長させる二段階の製造方式を開発しています。宇宙で作るのは種結晶のみで、基板の量産は地上で行います。

ブースでは、パネルと映像で次の内容をご紹介します。

- 宇宙での種結晶成長と地上での量産を組み合わせた製造方式
- NEDO「SBIR推進プログラム」（一気通貫型・フェーズ1）に採択された研究開発の内容
- 防衛・民生の両分野に向けた、国内で調達できる基板の供給体制づくり

会期中は、装備品メーカーや部材メーカーの皆さまとの個別の面談も承ります。技術の詳細は、秘密保持契約の締結後にご説明いたします。

今後の展開

BEAMは、本展示会での面談を通じて装備品メーカーや部材メーカーの皆さまが求める仕様を伺い、開発目標と供給計画に反映してまいります。NEDO「SBIR推進プログラム」で進める研究開発とあわせて、防衛・民生の両分野で使える化合物半導体基板の国内供給体制の構築を目指します。

※ 上記は現時点の計画であり、研究開発の結果により変わる可能性があります。

会社概要

理化学研究所発のスタートアップである当社は、独自のバンドエンジニアリング技術を軸に、化合物半導体AlGaN（アルミニウムガリウムナイトライド）において世界最高水準の出力を実現してきました。現在は、その結晶育成技術を応用し、AlGaNに限らず、地球の重力下では製造が困難な多様な化合物半導体の超高品質結晶を、宇宙の微小重力環境で製造するプラットフォームの構築に取り組んでいます。

会社名：株式会社BEAM Technologies
代表取締役：飯村 一樹
所在地：東京都千代田区二番町9番地3
設立：2022年3月
事業内容：微小重力を活用した半導体製造プラットフォーム事業
URL：https://beam-tec.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社BEAM Technologies 担当：田中
Email：info@beam-tec.co.jp